

2011年10月13日

LED パッケージ用「白色エポキシモールド樹脂」の採用実績が拡大 —LED 製品向け材料のラインナップが 10 製品に拡充—

日立化成工業株式会社(本社:東京、執行役社長:田中 一行、資本金:155億円)は、LEDパッケージ用「白色エポキシモールド樹脂 CEL-W-7005 シリーズ」(以下、白色モールド樹脂)の、お客様への採用実績が拡大しています。LED 製品向け材料は、白色モールド樹脂含め 10 製品のラインナップをそろえており、今後も需要が拡大する LED 市場での拡販に努め、2015 年度には合計で売上高約 80 億円を目指します。

LED は低消費電力、長寿命であることから、新しい光源としての採用が飛躍的に伸びています。用途としては、PC モニター、TV 等の液晶ディスプレイバックライト向けをはじめ、今後も照明や自動車ヘッドライト向け等に普及が進むものと見込まれています。LED は市場の拡大とともにさらなる高機能化が望まれ、ハイパワー化の傾向にありますが、駆動温度が上昇することで LED パッケージの構成材料にも負荷がかかります。そのため、LED パッケージ材料には、高耐熱、高伝導性、高信頼性の要求が高まってきました。

このようなニーズに対して、当社は、強みである半導体パッケージ用封止材の技術を活用し、パッケージのリフレクター部分に用いる「白色エポキシモールド樹脂」を製品化しました。これまでは熱可塑性樹脂が用いられてきましたが、高温での反射率の低下が大きいことから、当社は熱硬化性のエポキシ樹脂を用い、加えて特殊な配合技術により、高温時に反射率の低下が少なく、長寿命で信頼性が高い^(*)「CEL-W-7005」を開発しました。当製品は成形・加工性に優れ、お客さまの生産効率向上にも貢献します。当製品はすでに国内、海外のお客様に高い評価をいただき、LED 製品の普及とともに採用実績が拡大しています。

また、当社は白色モールド樹脂以外にも、LED 製品向け材料の開発、製品化を加速しており、現在は合計 10 製品のラインナップをそろえ拡販を進めています。10 月 1 日からは専任の営業体制を整え、お客さまの多種多様な設計・ニーズに対して最適な材料の組み合わせによるソリューションを提供し、2015 年度には LED 製品向け材料合計で売上高約 80 億円を目指します。

*:150℃の条件下で 1,000 時間使用した場合に、70%の反射率を保持します。(初期の反射率:93%)

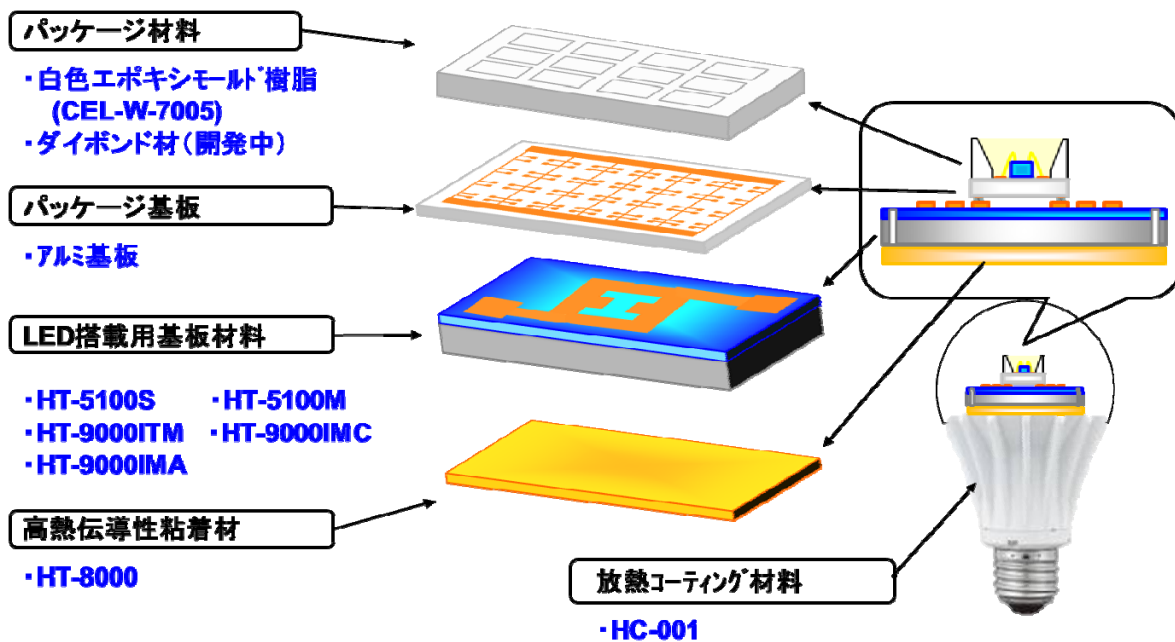
= ご参考 =



<白色エポキシモールド樹脂 CEL-W-7005>



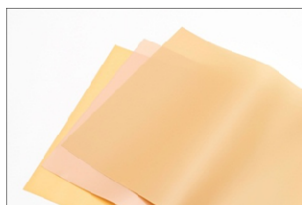
<LED パッケージ向け成形後>



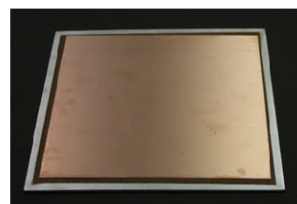
<LED 製品向け材料(当社製品)の LED 電球での使用例>



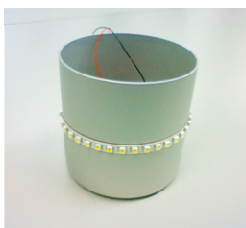
パッケージ基板
アル基板



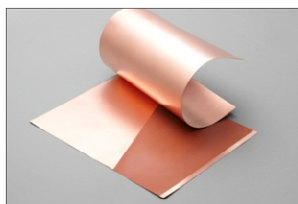
基板材料
高熱伝導絶縁接着シート HT-5100S



基板材料
HT-5100M
*9月27日既発表



基板材料
HT-9000ITM(用途例)
*9月27日既発表



基板材料
低熱抵抗フレキシ基材 HT-9000IMC



基板材料
HT-9000IMA
*9月27日既発表



高熱伝導性粘着材
HT-8000



放熱コーティング材
HC-001



パッケージ材料
高熱伝導ダイボンド材(開発中)

<白色エポキシモールド樹脂以外の当社の LED 製品向け材料ラインナップ>

以上

(報道関係お問い合わせ) 日立化成工業株式会社 コーポレートコミュニケーションセンタ

広報担当 長谷川、磯田 TEL:03-5381-2384、080-1384-0918